

证券代码：301611

证券简称：珂玛科技



**苏州珂玛材料科技股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金使用可行性分析报告**

二〇二五年八月

为了进一步提升苏州珂玛材料科技股份有限公司（以下简称“珂玛科技”或“公司”）的综合实力和核心竞争力，公司拟向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）。公司对本次向不特定对象发行可转债（以下简称“本次发行”）募集资金使用的可行性分析如下：

一、本次募集资金使用计划

本次向不特定对象发行可转债拟募集资金总额不超过人民币 75,000.00 万元（含 75,000.00 万元），扣除发行费用后，将全部投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金金额
1	结构功能模块化陶瓷部件产品扩建项目	60,273.00	48,800.00
2	半导体设备用碳化硅材料及部件项目	6,542.42	5,200.00
3	补充流动资金	21,000.00	21,000.00
合计		87,815.42	75,000.00

在本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换。如果本次发行募集资金扣除发行费用后少于上述项目募集资金拟投入的金额，募集资金不足部分由公司自筹资金解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

二、本次募集资金投资项目的实施背景

（一）先进陶瓷下游应用领域广阔，半导体市场持续增长拉动先进陶瓷市场需求

先进陶瓷是在众多国民经济重要领域中发挥着重要作用的关键基础材料。陶瓷材料具备优良材料特性，与金属材料、高分子材料并列为当代“三大固体材料”。先进结构陶瓷的下游应用领域主要包括半导体、显示面板、汽车制造和生物医药等，丰富的应用领域为先进陶瓷带来了广阔的市场前景，根据弗若斯特沙利文数据，2021年全球先进陶瓷市场规模达到3,818亿元，其中先进结构陶瓷为1,067亿元，占比28%；预计2022年至2026年全球先进结构陶瓷市场规模复合增速为4%。

半导体是先进结构陶瓷的重要应用领域。受AI芯片、高性能计算（HPC）及内存类

别支持数据中心扩展的需求所带动，全球半导体市场规模和半导体制造设备支出继续保持强劲的增长态势。根据SEMI数据，2024年全球半导体制造设备销售总额预计创1,128亿美元历史纪录，2025年全球预计将有18个新晶圆厂建设项目启动。全球半导体制造设备支出的增长亦带动先进陶瓷市场需求不断提升。

（二）先进陶瓷国产替代潜力巨大，半导体设备国产化需求带来发展机遇

全球先进陶瓷发展历史悠久，研发与工业化生产已经有超过100年的历史。二十世纪八十年代以来，先进陶瓷在全球得到突飞猛进的发展。中国先进陶瓷市场起步较晚但发展迅速，根据弗若斯特沙利文数据，2015年中国先进结构陶瓷国产化率仅约5%，到2021年已提高至约20%，不同领域的多项关键陶瓷零部件产品在不同程度上实现了国产替代。但目前半导体领域关键设备的国产替代率较低，国产设备中先进结构陶瓷国产替代率目前仍然不高，尤其陶瓷加热器、静电卡盘以及超高纯碳化硅套件等“功能-结构”模块类关键部件仍然依赖进口。

目前，中国大陆仍然稳居全球半导体设备支出龙头，根据SEMI数据，2024年中国大陆半导体设备支出总值约500亿美元，2025年预计有3座新晶圆厂的建设项目启动，相关半导体制造设备支出将有效带动国内先进陶瓷市场需求；此外，半导体设备中结构陶瓷部件国产化需求也不断提升。一方面，静电卡盘以及超高纯碳化硅套件等“功能-结构”模块类关键部件的国产空白亟需填补；另一方面，国内大量进口半导体设备里的先进陶瓷零部件需要定期更换，由于存在被原厂断供或限购的风险，先进陶瓷零部件国产化迫在眉睫，晶圆厂商迫切需要寻找国产替代方案，为先进陶瓷市场带来了发展机遇。

三、本次募集资金投资项目基本情况

（一）结构功能模块化陶瓷部件产品扩建项目

1、项目基本情况

本项目拟由公司实施，实施地址位于江苏省苏州市虎丘区，项目总投资额为60,273.00万元，拟使用本次募集资金金额为48,800.00万元。项目将重点建设静电卡盘生产线，并扩建陶瓷加热器产能，以满足我国半导体设备领域日益紧迫的关键零部件国产替代需求。

2、项目实施的必要性

（1）响应国家政策导向，助力半导体产业链自主可控

半导体行业作为信息技术产业的基石，是国家高度重视的战略性新兴产业。半导体设备及其关键零部件是半导体产业的先导、基础产业，近年来我国半导体设备行业在政策支持、技术创新与市场需求的多重因素驱动下得以快速发展，但仍存在诸多“卡脖子”环节，在半导体设备用先进陶瓷材料零部件领域仍然高度依赖进口。在当前国际贸易摩擦、地缘政治矛盾加剧的外部环境下，我国半导体设备关键零部件自主可控需求日益强烈。近年来，国家密集出台政策强化半导体产业的战略地位，明确要求加速关键材料与高端装备国产化进程。

国家层面，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》提出，到 2025 年重点新材料的整体技术水平需与国际同步，部分领域实现国际领先，全面提升高端材料自给能力。《中国制造 2025》、《关于扩大战略性新兴产业投资培育壮大新增长点增长极的指导意见》等文件提出重点支持半导体设备配套产业发展。国家发改委《产业结构调整指导目录（2024 年版）》亦将“高性能陶瓷制造技术开发与生产”列为鼓励类产业。地方层面，江苏省将新材料产业定位为先进制造业支柱，致力于打造万亿级产业集群。《江苏省制造业高质量发展行动计划》明确提出推动高性能新材料与关键零部件产业发展。

公司是我国本土先进陶瓷材料及零部件领先企业之一，多年来公司积极推动半导体设备用高纯度氧化铝、高导热氮化铝等多项“卡脖子”产品加快实现国产替代，在陶瓷加热器、静电卡盘和超高纯碳化硅套件等高精尖产品的研发和产业化处于国内同行业企业前列。本项目紧跟政策导向，依托公司在先进陶瓷材料领域的多年技术积累，瞄准半导体设备领域“卡脖子”零部件，扩大陶瓷加热器规模、推进陶瓷静电卡盘产业化。项目的实施将有效缓解我国半导体设备关键陶瓷零部件的进口依赖，填补陶瓷静电卡盘国产空白，提升产业链自主可控能力，助力国产替代进程。

（2）把握高端零部件国产替代市场机遇，加速产能布局抢占市场份额

全球半导体资本开支回暖，推动半导体设备及核心零部件需求进入高速增长期。我国作为主要的半导体制造中心之一，拥有巨大的半导体设备及核心零部件需求和产业发

展潜力，同时具有产业链自主可控的需求。公司作为国内本土先进陶瓷材料及零部件的领先企业之一，近年来抓住全球半导体资本开支回暖和下游需求提升、中国大陆半导体设备关键零部件国产化不断推进的市场机遇，持续完善产品和市场布局，实现了先进陶瓷材料零部件业务规模快速增长，目前公司在半导体设备用先进陶瓷领域已处于国内领先地位。

我国半导体行业国产化替代趋势预计未来仍将继续，并进一步带动核心零部件，尤其是产业链“卡脖子”产品需求的提升。随着公司已量产的陶瓷加热器产品进一步放量，更多型号陶瓷加热器及静电卡盘等新产品陆续通过客户验证，公司将需要大量产能以匹配客户需求。

为抓住国产替代窗口期，本项目将基于研发成果与市场规划，扩建陶瓷加热器、静电卡盘等核心产品的产能。通过对现有产品的前瞻性布局和产能扩张，公司将能够快速响应客户订单增量需求，抢占半导体设备关键零部件市场份额。项目落地后，将进一步巩固公司在国产供应链中陶瓷加热器和静电卡盘产品的先发优势，持续为公司在半导体设备领域的市场开发提供支撑，帮助公司拓展先进陶瓷材料零部件领域的市场份额。

（3）升级工艺强化制造能力，夯实高端产品技术壁垒

陶瓷加热器和静电卡盘是半导体前道核心设备中的关键功能部件，广泛应用于刻蚀、沉积、热处理等高精密工艺环节，对材料性能、结构稳定性、热均匀性与电性能的一致性要求极高，技术壁垒显著。在先进制程不断进步的背景下，陶瓷加热器和静电卡盘需具备在极端真空、高温、高电压、高洁净等复杂环境中长时间稳定运行的能力，这在陶瓷基体的致密性、绝缘性、热导率等方面对其制备工艺提出极高挑战。

当前，国际领先厂商在大尺寸、高致密度、高可靠性的陶瓷加热器和静电卡盘的研发和量产上积累了几十年的经验，形成深厚的技术壁垒。相比之下，公司虽在陶瓷加热器产品的研发和产业化方面实现重大突破，但在高端静电卡盘产业化环节仍有待突破，现有生产平台难以满足客户对高端静电卡盘批量化生产要求，制约了产品规模化推广进程。

为此，公司拟建设静电卡盘生产基地，规划引入包括高性能等静压成型设备、高温烧结系统等关键工艺装备，打造高端功能陶瓷制造平台。通过本项目实施，公司在静电

卡盘产业化方面实现技术跃升，显著提升产品良率与综合性能指标，满足客户多规格、多场景的定制化需求。项目不仅将填补国内企业在静电卡盘产品方面的产业化空白，改善国内半导体刻蚀设备用静电卡盘产品依赖进口的局面，也将强化公司在半导体核心部件国产化中的战略地位，进一步提升核心竞争力。同时考虑到陶瓷加热器产品的产能未来达到饱和且在研陶瓷加热器产品不断实现量产和销售，该新生产基地将承接陶瓷加热器产品的部分新增产能需求。

3、项目实施的可行性

（1）市场需求强劲叠加国产替代窗口期，项目产能消化基础坚实

陶瓷加热器及静电卡盘作为半导体制造设备的重要部件，广泛应用于刻蚀、CVD、PVD 等半导体设备。近年来，全球半导体设备市场持续扩容，带动了陶瓷加热器及静电卡盘等先进陶瓷材料市场规模提升。根据市场调研机构 QY Research 数据，2023 年全球半导体陶瓷加热器市场规模约 103.2 亿元，预计到 2030 年市场规模将接近 152.6 亿元，年复合增长率约为 5.8%。根据 DI Resaerch 研究统计，2024 年全球半导体用静电卡盘规模达到 137.1 亿元，预计 2030 年将达到 194.2 亿元，期间年复合增长率为 5.97%。

陶瓷加热器和静电卡盘技术门槛高，国产起步晚，进口依赖度高，在国际贸易局势不容乐观、我国经济转型和产业升级日益迫切的大背景下，我国半导体产业内对于先进陶瓷材料零部件，尤其是陶瓷加热器及静电卡盘等高端产品进口替代的需求愈发强烈。

本项目产品为陶瓷加热器、陶瓷静电卡盘，我国半导体产业良好的发展前景和高端先进陶瓷材料进口替代需求为本项目新增产能的消化建立了良好的市场基础。

（2）深厚的核心技术积累，为项目实施建立坚实技术基础

公司是国内本土先进陶瓷材料及零部件的领先企业之一，经过十余年的技术积累，公司掌握了先进陶瓷材料从配方制备、成型烧结到精密加工、表面涂覆的全流程关键工艺，自主构建了完整的材料配方和工艺技术体系。依靠自主创新，公司不断完善先进陶瓷产品体系并成功实现多项技术突破，填补了高纯度氧化铝陶瓷、高导热氮化铝陶瓷等国内多项空白，关键性能指标达到国内领先、国际主流水平。

公司自 2016 年承接国家“02 专项”课题“PECVD 设备用陶瓷加热盘的关键技术与产业化”起，开始布局陶瓷加热器，掌握了用于陶瓷加热器的氮化铝陶瓷材料配方以

及特殊成型和多次高温烧结工艺、复杂加工工艺和表面处理等特殊工艺要求。2020 年公司课题通过重大专项验收,随即与多家半导体设备厂商继续合作研发半导体设备用陶瓷加热器。基于多年技术积累、研发及产业化布局,2023 年末开始公司半导体设备核心部件陶瓷加热器实现国产替代,该“结构-功能”一体模块化产品解决了半导体晶圆厂商 CVD 设备关键零部件的“卡脖子”问题。公司为半导体晶圆厂商和国内半导体设备厂商研发生产并销售多款陶瓷加热器产品,装配于 SACVD、PECVD、LPCVD 和激光退火等设备,部分陶瓷加热器产品已量产并大量应用于晶圆的薄膜沉积生产工艺流程,而且公司还有多款陶瓷加热器产品通过多个半导体晶圆厂及国内半导体主流设备厂商认证。

静电卡盘方面,公司自 2020 年 8 月起已建立起静电卡盘产品技术体系和基础检测体系能力,并主要通过自主研发等方式积极推进静电卡盘产品研发及产业化应用。目前公司静电卡盘已通过部分客户验证并实现小规模量产,同时推进更多客户的验证测试。公司建立了与行业需求高度契合的创新机制,拥有经验丰富的研发技术团队,并具备了规模化生产的丰富经验,对先进陶瓷应用、发展方向形成了深刻理解并进行相应的研发布局,为项目静电卡盘的产业化落地建立了坚实保障。

综上所述,公司在先进陶瓷材料零部件领域具备较强的技术实力,在陶瓷加热器及静电卡盘方面拥有坚实的技术基础,为项目的产品竞争力提供了有力保障,保证项目的顺利实施。

(3) 优质客户资源与品牌效应,为项目市场拓展建立坚实保障

公司深耕先进陶瓷行业多年来,凭借领先的技术、严格的品质管理和优质的服务形成了良好的客户口碑,成为少数进入国际主流半导体设备供应链的本土企业,在国内竞争对手中处于市场领先地位。经过多年市场积累,公司已与下游领先企业建立了长期稳定且深入的合作关系。在半导体领域,公司拓展了 A 公司、北方华创、中微公司、拓荆科技等知名半导体厂商,逐步形成了品牌效应,打造了良好的口碑。此外,公司通过合作研发等方式,已与多家知名半导体生产企业展开针对项目产品的前期技术接洽,进一步夯实与主要终端客户合作关系,为本项目产品销售建立保障。

4、项目投资概算

本次募投项目之“结构功能模块化陶瓷部件产品扩建项目”的投资总额为60,273.00

万元，拟使用本次募集资金金额为48,800.00万元。

5、项目建设用地及项目备案、环评情况

本项目拟通过新增土地实施，目前公司正在筹备获取苏州市高新区某工业用地地块的土地使用权事项。截至本报告出具之日，本项目的备案已经取得，环评手续正在办理中。公司将按照国家相关法律、法规要求及时、合规办理。

（二）半导体设备用碳化硅材料及部件项目

1、项目基本情况

本项目拟由公司子公司安徽珂玛材料技术有限公司实施，实施地址位于安徽省滁州市，项目总投资额为6,542.42万元，拟使用本次募集资金金额为5,200.00万元。项目拟在安徽现有碳化硅材料工厂基础上，租赁厂房购置生产设备扩建碳化硅陶瓷结构件产品全流程生产工厂。

2、项目实施的必要性

（1）碳化硅系列产品市场放量及产业化加速，亟需建设专用生产场地

碳化硅陶瓷材料以其独特性能在半导体设备材料体系中占据了不可替代的功能定位，近年来，其国产化进程加快，市场空间持续释放。公司作为国内先进陶瓷材料及零部件的领先企业之一，多年来通过在粉末加工技术、成型技术、精密加工技术等核心技术方面的持续研发投入，在超高纯碳化硅套件等碳化硅产品领域取得突破性进展，目前公司碳化硅结构件以及部分超高纯碳化硅套件产品已实现量产，同时推进更多型号的超高纯碳化硅套件产品进入量产推广和客户验证阶段。

然而，公司当前碳化硅产品的产能规模较小，且生产工序分散，难以充分支撑未来产能需求。随着市场推广的深入，公司亟需配套建设稳定产能体系，以保障碳化硅产品的规模化生产能力。

为此，公司结合产品开发和市场拓展节奏，拟通过本项目的实施集中生产环节，建设碳化硅产品专用生产场地，前瞻性布局碳化硅陶瓷结构件及超高纯碳化硅套件的规模化产能，保障产品体系的产业化落地，进一步推动公司主营业务的发展。

（2）整合资源优化布局，提升管理效能与响应能力

早期受公司经营场地和生产规模限制，公司碳化硅产品线布局分散在安徽和苏州两地，其中粉体制备、成型等前段生产工序设在安徽工厂，后段的精密加工工序设在苏州基地。由于公司产品多为客户定制开发，不同产品在材料配方、工艺流程及参数控制方面存在显著差异，客户订单具有批量小、品种多、采购频率高的特征。

近年来，随着公司业务规模的快速增长，产品体系不断扩展，现有生产布局已难满足公司生产需求。一方面影响碳化硅产品的制造效率和质量控制，另一方面，跨区域生成也在一定程度上限制了公司快速响应客户需求、灵活组织产能的能力。

为科学布局，公司拟在安徽现有碳化硅材料工厂基础上，租赁专用厂房扩大产线空间，并引进配套先进设备，建设专门用于碳化硅陶瓷结构件全流程制造的专用生产场地。项目建成后，将显著提升公司碳化硅系列产品的制造效率和质量稳定性，降低物流成本，提高公司交付响应能力。集中化布局也将提升整体管理效率与团队协同能力，更有效应对当前以定制化、小批量为特征的市场需求，增强公司在高端陶瓷材料领域的核心竞争力。

(3) 推进高端碳化硅产品产业化，优化先进陶瓷材料产品体系

十余年来，公司始终深耕先进陶瓷材料领域，持续加强自主研发投入与技术体系建设，已建立起涵盖氧化铝、氧化锆、氮化铝、碳化硅、氧化钇和氧化钛在内的六大类基础陶瓷材料体系，具备较为完备的产品体系。

尽管公司在氧化物陶瓷及氮化物陶瓷领域已具备规模化产品能力与批量化交付经验，但在碳化硅产品体系方面，尚未形成对高端碳化硅结构件，特别是超高纯重结晶碳化硅套件的系统化产业布局。作为公司重点突破方向之一，超高纯碳化硅套件历经多年研发，已取得阶段性成果，具备规模化推进基础。

为加快推动碳化硅高端产品板块的产业化落地，公司拟通过本项目建设碳化硅陶瓷专用产线，打造适用于超高纯碳化硅套件等碳化硅结构件产品的精密制造平台，全面覆盖从粉体制备、成型、烧结、后加工到质量控制、精密清洗的关键工艺环节。项目建成后，公司将形成高性能碳化硅结构件的规模化供货能力，进一步优化陶瓷材料产品结构，推进公司向国际一流水平的半导体设备关键零部件高技术企业升级转型。项目的实施有

利于进一步提升公司在半导体设备核心材料领域的综合竞争力,巩固公司在我国先进陶瓷领域的领先地位。

3、项目实施的可行性

(1) 市场需求强劲叠加自主可控驱动,项目具备良好产能消化基础

碳化硅陶瓷材料具有高硬度、高熔点、高耐磨性和耐腐蚀性,以及优良的抗氧化性、高温强度、化学稳定性、抗热震性、导热性和气密性等优点,因此可以用于制造半导体零部件产品,并广泛应用于包括外延/氧化/扩散等热处理、研磨抛光、光刻、沉积、刻蚀等半导体制造核心工艺的关键设备当中。近年来,受新能源汽车、AI服务器、高性能计算机等终端市场需求带动,全球半导体晶圆制造产能不断扩张,从而直接拉动了对半导体设备及零部件产品的市场需求,为本项目的碳化硅零部件及超高纯碳化硅套件产品提供了广阔的市场空间。

本项目拟产业化的产品面向半导体制造关键设备领域,包括碳化硅零部件及超高纯碳化硅套件,产品市场需求将随着全球半导体晶圆制造产能、半导体设备市场需求的增长而持续增长。此外,美国 CoorsTek 占据了上述产品超过 80%的市场份额,在我国半导体产业自主可控需求不断加强的背景下,本项目具有良好的市场前景。

(2) 技术体系成熟工艺积累深厚,项目具备高端产品量产能力

碳化硅陶瓷材料因其高硬度、高耐磨、高耐腐蚀、优异的热导率和优良的高温力学性能,近年来在半导体制造装备、新能源光伏、高端冶金装备、航空航天、特种装备等领域的应用需求快速增长,成为先进陶瓷材料的重要发展方向。当前,碳化硅陶瓷制品向高性能结构件、功能件演进,其制备技术和工艺装备水平在材料纯度控制、微观结构优化、精密成型与烧结控制、表面处理及复杂形貌加工能力等方面面临更高要求。

公司作为国内领先的碳化硅陶瓷材料企业,经过多年技术积累,已掌握包括反应烧结碳化硅(RBSiC)、重结晶碳化硅(R-SiC)等制备工艺,并具备工业规模生产能力。公司团队在杂质控制技术、致密化技术、大面积超高纯陶瓷涂层表面改性技术以及工艺装备等方面开展了专项技术攻关,已取得关键技术突破,具备产业化条件。

(3) 契合产业政策发展方向,项目实施具备良好政策基础

高性能陶瓷是《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年

远景目标纲要》所强调的深入实施制造强国战略、提升制造业核心竞争力的重点领域之一。《“十四五”原材料工业发展规划》将先进陶瓷材料列入新材料创新发展工程重点突破品种。

碳化硅陶瓷材料作为新型高性能陶瓷材料，是先进制造业关键基础材料之一，广泛应用于半导体装备、新能源光伏、航空航天、高端冶金装备等战略性新兴产业，属于国家大力支持发展的重点产业方向。《重点新材料首批次应用示范指导目录（2024年版）》将刻蚀装备用碳化硅电板、刻蚀装备用碳化硅环、6寸及以上高温扩散工序用烧结碳化硅舟、6寸及以上高温扩散工序用CVD碳化硅舟、6寸及以上高温扩散工序用烧结碳化硅炉管、6寸及以上高温扩散工序用CVD碳化硅炉管等半导体装备用精密陶瓷部件产品列入关键战略材料，并进行政策扶持。地方层面，安徽省近年来出台多项扶持政策推动新材料产业高质量发展，将新材料产业列为“十四五”时期重点发展的十大新兴产业之一。《安徽省材料及新材料产业“十四五”发展规划》将结构陶瓷粉末纳入新材料布局重点。

本项目建成后，主要用于半导体设备用碳化硅陶瓷材料及部件生产，产品定位符合国家新材料战略布局，符合我国半导体装备等重点支持产业的国产替代需求，契合国家和地方产业政策重点方向，具备良好的产业政策可行性，为项目顺利实施和未来发展提供有力政策支撑。

4、项目投资概算

本次募投项目之“半导体设备用碳化硅材料及部件项目”的投资总额为6,542.42万元，拟使用本次募集资金金额为5,200.00万元。

5、项目建设用地及项目备案、环评情况

本项目拟在租赁场地实施，不涉及新增土地。截至本报告出具之日，本项目的备案已经取得，环评手续正在办理中。公司将按照国家相关法律、法规要求及时、合规办理。

（三）补充流动资金

1、项目基本情况

公司拟使用本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金中的21,000.00万元补充公司流动资金。

2、项目实施的必要性和合理性

近年来，公司业务保持快速发展，收入和资产规模稳步提升。随着业务规模的扩大，公司仅依靠内部经营积累和间接融资较难满足业务扩张对营运资金的需求。本次公司拟将募集资金中的21,000.00万元用于补充流动资金，符合公司所处行业发展现状及公司业务发展需求。募集资金到位后，公司营运资金需求将得到有效满足，资产结构更加稳健，可进一步提升公司的整体抗风险能力，保障公司持续稳定发展，具备必要性和合理性。

四、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响

（一）对公司经营管理的影响

本次发行募集资金的运用符合国家相关的产业政策以及公司整体战略发展方向，具有良好的市场发展前景和经济效益，有利于提升公司综合实力，对公司战略的实现具有积极意义。项目完成后，将显著增强公司在先进陶瓷材料及零部件领域的综合竞争实力，提高公司持续盈利能力，巩固提升行业地位。本次发行募集资金的运用合理、可行，符合公司及全体股东的利益。

（二）对公司财务状况的影响

本次发行完成后，公司总资产和净资产规模将有所增加，资金实力将得到强化，资产负债率有所降低，整体财务状况将得到进一步改善，增强公司抵御财务风险的能力，优化资产结构，降低公司的财务风险。

五、结论

综上所述，本次募集资金投资项目符合国家相关产业政策、行业发展趋势以及公司未来发展规划，具有良好的市场前景和经济效益，对于整体提升公司竞争实力，增强公司可持续发展能力具有重要的战略意义。本次募集资金投资项目具有必要性和可行性，符合公司及公司全体股东的利益。

苏州珂玛材料科技股份有限公司董事会

2025年8月22日